

# **INDEX**

FPCB LEADER
YOUNGFLEX

## 01 회사소개

- -. 회사 설립
- -. 회사 개요

## 02 사업영역

- -. CAPA
- -. 기술현황
- -. 사업분야

# 03 차별성

- -. FPCB RTR 특허
- -. CFRP 가공 특허

회사소개 기업명 ㈜영플렉스 설립일 2022. 11. 01 / 2024. 12. 01 법인 전환 본사 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 세부 주소 310동 305호(원곡동, 트리플렉스) 대표이사 윤영도 사업개요 연성 인쇄 회로기판 제조 자본금 1억

### 사업영역\_ APPLICATION(1PART)

사업 영역 제조 PART

FPCB & PCB를 기반으로 다양한 APPLICATION 제공 신소재(CFRP, GFRP, UV C/F) 수급 및 가공 기술 보유

















#### **F/RFPCB**

- ✓ F/RFPCB 제조
- ✓ 고난이도 제조 전문

#### HARD PCB

- ✓ HARD PCB 제조
- ✓ 샘플.양산 제조가능

### 원자재 공급

- ✓ CFRP 공급 및 가공
- ✓ FPCB관련 소재 공급

#### **MACHINE**

- ✓ F/RFPCB 관련 설비
- ✓ 비 접촉식 클린머신

TYPE	UNIT	DAY	MONTH	NOTE
	PCS	300,000	7,500,000	1PNL: 100PCS 기준
FPCB S/S	PNL	300	7,500	1SQM: 10PNL 기준
	SQM	30	750	
	PCS	300,000	7,500,000	1PNL: 100PCS 기준
FPCB D/S	PNL	300	7,500	1SQM: 10PNL 기준
	SQM	30	750	
FPCB MLB	SQM	20	500	
RFPCB	SQM	20	500	
PCB D/S	SQM	300	75,000	
PCB MLB	SQM	300	75,000	

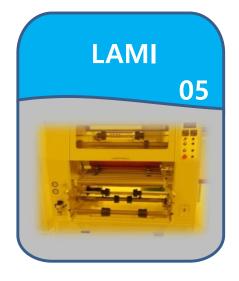
# 사업영역\_FPCB PROCESS





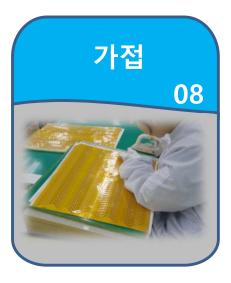












# 사업영역\_FPCB PROCESS

















## 차별성

17년 동안 FPCB 제조관련하여 생산기술과 설계기술을 보유하고 있으며, 맞춤형으로 설계 및 제작 가능



- 1. 단면을 양면으로 제조 기술
- 2. FPCB RTR 제조 기술
- 3. 적층 시 기포제거 설계기술



- 1. 특수 원자재 사양 제조
- 2. RFPCB 고다층 제조
- 3. 개발 아이디어 제품 제조



- 1. 동일자재 조합 설계
- 2. 협력사 스페셜 단가 적용
- 3. Process 단순화(일괄적층)

5G	원자재. 부자재	공정 조건
	- Polyimide Film - Adhesive - Release Paper	
✓ 5G用 원자재 적용 가능	<ul><li>✓ 이온마이그레이션소재</li><li>적용 가능</li></ul>	✓ 40/40 Pattern 형성 가능
✓ 저유전 원.부자재 적용	기 이 기 이 기 이 기 이 기 이 기 이 기 이 기 이 기 이 기 이	✓ 고다층 적층 조건 수립
✓ 저유전 관련 조건 수립		✓ 층간 정합 기술 보유
완료 	✔ 맞춤형 원부자재 적용 (FCCL, P.I, COVERLAY등)	✓ 임피던스 관리 가능
신소재 차별화	특수 자재 차별화	공정 조건 차별화

Unit: µm

<b>Application</b>	Type	Line/Space	<b>Ball Pitch</b>	Via/Pad	<b>Cu Plating</b>
Display	Double Side	65/65		120/360	9~15
	Rigid Flexible	75/75		200/400	12~18
Camera Module	Double Side	65/65	0.35	120/360	9~15
	Rigid Flexible	75/75	0.35	200/400	12~18
Cable	Double Side	65/65		120/360	9~15
	Rigid Flexible	75/75		200/400	12~18

Type	Display	Rigid Flexible	Cable	
Design			The state of the s	

